

证券代码：688380

证券简称：中微半导体

公告编号：2024-035

中微半导体（深圳）股份有限公司

关于调整募投项目内部投资结构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募投项目的实施进度等因素，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整募投项目“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”、“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”、“车规级芯片研发项目”的内部投资结构。公司监事会对该事项发表了明确的同意意见，该事项无需提交公司股东大会审议；保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。具体情况如下：

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），本公司由主承销商中信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票6,300万股，发行价为每股人民币30.86元，共计募集资金194,418.00万元，坐扣承销和保荐费用10,409.26万元（其中，不含税承销费为人民币98,200,566.04元，该部分属于发行费用，税款为人民币5,892,033.96元，该部分不属于发行费用）后的募集资金为184,008.74万元，已由主承销商中信证券股份有限公司于2022年8月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用2,947.86万元后，公司本次募集资金净额为181,650.09万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2022〕3-73号）。

募集资金到账后，已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金三方及四方监管协议。

二、募集资金投资项目的的基本情况

根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司募投项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金
1	大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业化项目	19,356.49	19,356.49
2	物联网 SoC 及模拟芯片研发及产业化项目	13,253.32	13,253.32
3	车规级芯片研发项目	28,275.05	28,275.05
4	补充流动资金	12,000.00	12,000.00
	合计	72,884.86	72,884.86

三、调整部分首次公开发行股票募投项目内部投资结构的情况说明

(一) 调整“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”“车规级芯片研发项目”内部投资结构的原因

1、由于公司募投项目在列示内部投资结构时将流片费用列入研发费用之中，与公司会计处理方法存在差异（公司会计处理中仅将研发失败的流片费（MASK费用和工程批晶圆）计入当期研发费用，而把研发成功的流片费用（MASK和工程批）计入长摊费用从而计入产品成本），导致流片费在支付时尚无法判定是否计入研发费用而无法使用募投资金。为确保募投资金的正确使用和募投项目的有效推进，公司计划将流片费从研发费用中剥离出来单独列示，在流片费支付时直接从该部分预算额中列支，其费用归属根据后期研发结果按照公司会计处理方法进行处理，即将研发成功的流片费用列入长摊费用，将研发失败的流片费用列入研发费用。

2、为加强项目自研，更多实现项目自主可控，公司计划减少项目的软件使用费和IP费，加大人员工资投入；

3、此外鉴于车规级研发项目能够提前实现产业化，公司计划将其中的部分软件使用费、IP费调整为流片费和外委测试分析，从而推动项目更早产业化。

综上，为进一步提升募集资金使用效率，加快募集项目的推进，公司拟在“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”“车规级芯片研发项目”投资总额不变的情况下，调整募集资金内部结构的投资情况，将流片费从研发费用中剥离出来单独列示，并对研发费用明细项及铺底流动资金的金额进行相应的调整。

(二) 内部投资结构调整的具体情况

公司拟调整首次公开发行股票募投项目“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”“车规级芯片研发项目”的内部投资结构，具体调整情况如下表：

1、调整前募投项目内部投资结构

募投项目		大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目	物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目	车规级芯片研发项目
序号	投资项目	金额（万元）		
		调整前	调整前	调整前
1	工程建设费用	2,115.00	1,637.00	6,770.64
2	研发费用	11,932.00	7,880.00	20,950.00
2.1	其中：研发人员工资	5,592.00	4,980.00	10,500.00
2.2	软件使用费	1,080.00	-	1,080.00
2.3	IP费	2,000.00	100.00	3,000.00
2.4	流片费	2,960.00	2,400.00	6,000.00
2.5	工程验证费	200.00	300.00	27000
2.6	外委测试分析	100.00	100.00	100.00
3	基本预备	280.94	190.35	554.41
4	铺底流动资金	5,028.55	3,545.97	-
合计		19,356.49	13,253.32	28,275.05

2、调整后募投项目内部投资结构

募投项目		大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目		物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目		车规级芯片研发项目	
序号	投资项目	金额（万元）					
		调整后	增减金额	调整后	增减金额	调整后	增减金额
1	工程建设费用	2,115.00	-	1,637.00	-	6,770.64	-
2	研发费用	8,972.00	-2,960.00	5,480.00	-2,400.00	13,700.00	-7250.00
2.1	其中：研发人员工资	7,292.00	1,700.00	4,980.00	-	11,500.00	1,000.00
2.2	软件使用费	380.00	-700.00	-	-	430.00	-650.00
2.3	IP费	1,000.00	-1,000.00	100.00	-	1,000.00	-2,000.00
2.4	工程验证费	200.00	-	300.00	-	270.00	-

2.5	外委测试分析	100.00	-	100.00	-	500.00	400.00
3	基本预备	280.94	-	190.35	-	554.41	
4	铺底流动资金	5,028.55		3,545.97		1,250.00	1,250.00
5	流片费（单独列示）	2,960.00		2,400.00		6,000.00	
	合计	19,356.49	-	13,253.32	-	28,275.05	-

四、对公司的影响

公司本次调整首次公开发行股票“大家电和工业控制MCU芯片研发及产业化项目”“物联网SoC及模拟芯片研发及产业化项目”“车规级芯片研发项目”内部投资结构系基于公司会计处理方法、公司业务发展规划以及募投项目实际实施情况做出的审慎性决策，是对募投项目建设资金进行的合理调度和科学安排，未改变募投项目实施主体及募集资金投资总额，不存在改变或者变相改变募集资金投向的情形。本次调整有利于提高整体募集资金的使用效率，加快募投项目的有效推进，不存在损害公司及股东利益的情况，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。

五、履行的审议程序

公司于2024年8月26日召开第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十四次会议，审议通过了《关于调整募投项目内部投资结构的议案》，综合考虑当前募集资金投资项目的实施情况，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资总额不变的情况下，调整上述相关募投项目的内部投资结构。公司监事会对上述事项发表了同意的独立意见。该议案无需提交公司股东大会审议。

六、专项意见说明

（一）监事会意见

监事会认为：本次调整部分募集资金投资项目内部投资结构系基于市场环境、公司业务发展规划以及项目实际实施情况作出的审慎性决策，符合项目建设的实际情况和公司经营规划。本次调整不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文

件及《公司章程》《募集资金管理制度》等规定。综上，监事会同意公司本次调整募集资金投资项目的内部结构。

（二）保荐机构意见

经核查，保荐人认为：公司本次调整募集资金投资项目内部结构的事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序，符合相关法律法规的规定要求。上述事项符合公司募投项目进展的实际情况，不存在变相改变募集资金投向和损害股东特别是中小股东利益的情形。

综上，保荐人对公司调整募投项目内部投资结构的事项无异议。

特此公告。

中微半导体（深圳）股份有限公司董事会

2024年8月28日